



Institut luxembourgeois de la normalisation
de l'accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services

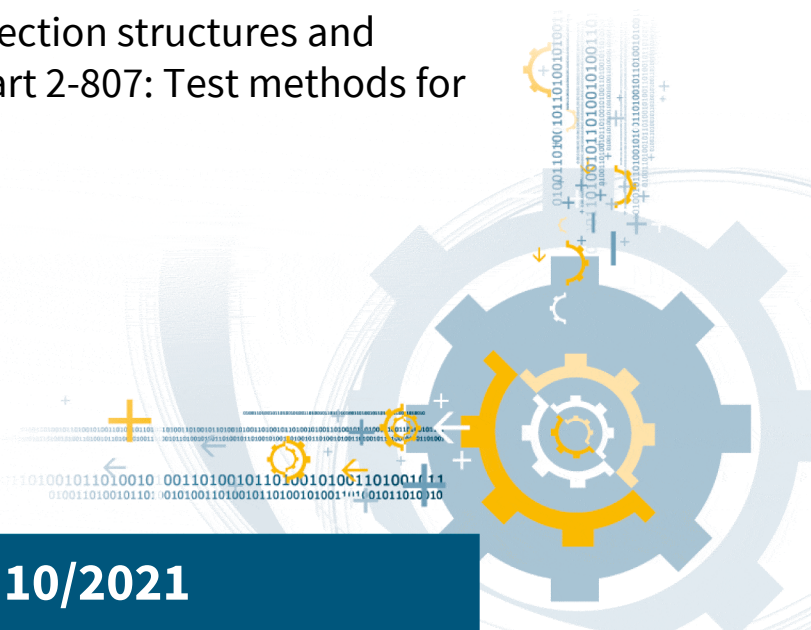
ILNAS-EN IEC 61189-2-807:2021

Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles - Partie 2-807: Méthodes

Prüfverfahren für Elektromaterialien,
Leiterplatten und andere
Verbindungsstrukturen und Baugruppen
– Teil 2-807: Prüfverfahren für Materialien

Test methods for electrical materials,
printed boards and other
interconnection structures and
assemblies - Part 2-807: Test methods for

10/2021



Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN IEC 61189-2-807:2021 a été adoptée comme Norme Luxembourgeoise ILNAS-EN IEC 61189-2-807:2021.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) :

- Influencer et participer à la conception de normes
- Anticiper les développements futurs
- Participer aux réunions des comités techniques

<https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html>

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR

Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres moyens sans autorisation préalable !

ILNAS-EN IEC 61189-2-807:2021

NORME EUROPÉENNE **EN IEC 61189-2-807**
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

Octobre 2021

ICS 31.180

Version française

**Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles -
Partie 2-807: Méthodes d'essai des matériaux pour structures d'interconnexion - Température de décomposition (T_d) par analyse thermogravimétrique
(IEC 61189-2-807:2021)**

Prüfverfahren für Elektromaterialien, Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen und Baugruppen - Teil 2-807: Prüfverfahren für Materialien für Verbindungsstrukturen - Zersetzungstemperatur (T_d) unter der Nutzung von TGA
(IEC 61189-2-807:2021)

Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-807: Test methods for materials for interconnection structures - Decomposition temperature (T_d) using TGA
(IEC 61189-2-807:2021)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2021-10-08. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à cette Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du CEN-CENELEC Management Centre ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au CEN-CENELEC Management Centre, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

Avant-propos européen

Le texte du document 91/1697/CDV, future édition 1 de IEC 61189-2-807, préparé par le CE 91 de la CEI, "Techniques d'assemblage des composants électroniques", a été soumis au vote parallèle IEC-CENELEC et approuvé par le CENELEC en tant que EN IEC 61189-2-807:2021.

Les dates suivantes sont fixées:

- date limite à laquelle ce document doit être mis en application au (dop) 2022-07-08
niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement
- date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être (dow) 2024-10-08
annulées

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information et toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve sur le site web du CENELEC.

Notice d'entérinement

Le texte de la Norme internationale IEC 61189-2-807:2021 a été approuvé par le CENELEC comme Norme Européenne sans aucune modification.

Annexe ZA

(normative)

Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE 1 Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN/le HD correspondant(e) s'applique.

NOTE 2 Les informations les plus récentes concernant les dernières versions des Normes Européennes listées dans la présente annexe sont disponibles à l'adresse suivante: www.cenelec.eu.

<u>Publication</u>	<u>Année</u>	<u>Titre</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Année</u>
IEC 60194-2	-	Printed boards design, manufacture and-assembly - Vocabulary - Part 2: Common usage in electronic technologies as well as printed board and electronic assembly technologies		-
ISO 11358-1	-	Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 1: General principles	of EN ISO 11358-1	-



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies –

**Part 2-807: Test methods for materials for interconnection structures –
Decomposition temperature (T_d) using TGA**

Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres structures d'interconnexion et ensembles –

Partie 2-807: Méthodes d'essai des matériaux pour structures d'interconnexion – Température de décomposition (T_d) par analyse thermogravimétrique

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	11
1 Domaine d'application	13
2 Références normatives	13
3 Termes et définitions	13
4 Éprouvettes d'essai	13
5 Appareillage d'essai	14
6 Procédure d'essai	14
7 Rapport	15
Bibliographie.....	17
 Figure 1 – Courbe masse-température	 15